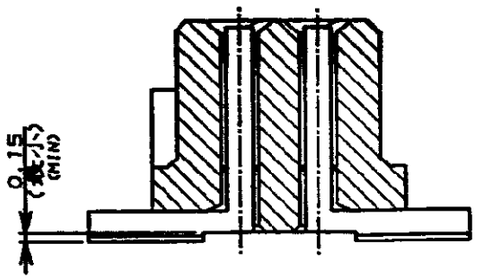
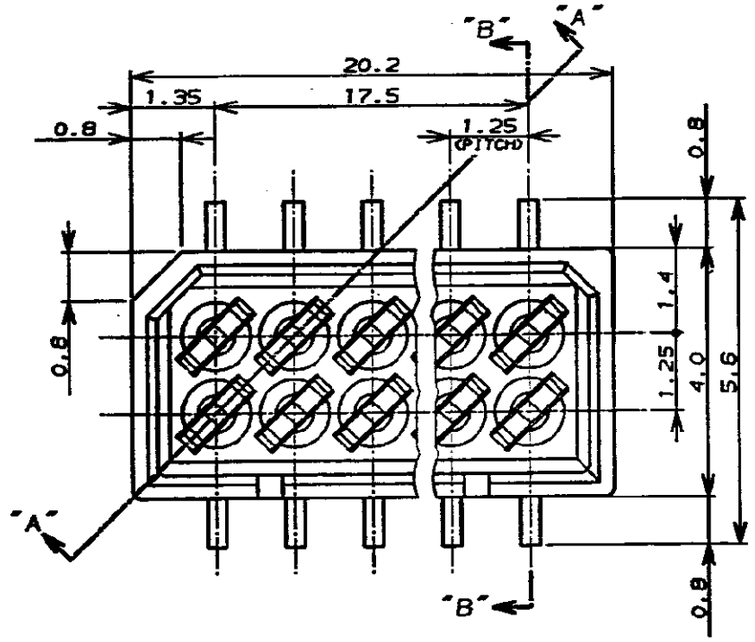


SECT "B"-"B"

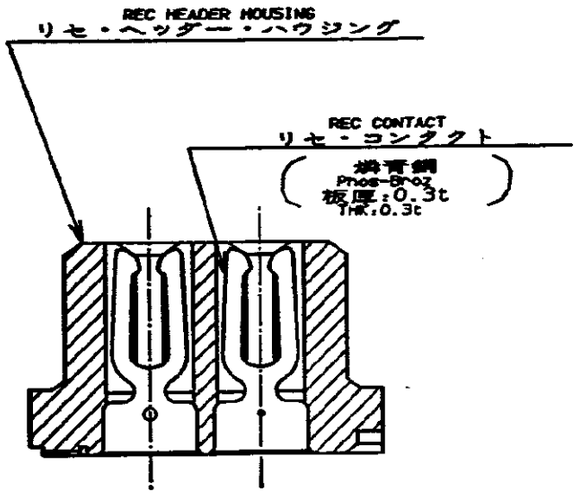


注記:

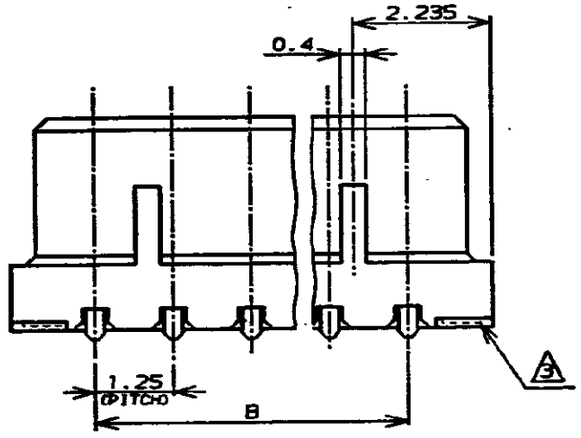
1. 材料及び仕上
   - ハウジング : LCP UL94V-0 (白色)
   - コンタクト : リン青銅
   - めっき仕様 : ニッケル下地 1μ 以上
     デュラゴールド 0.5μ 以上
     (金:15%,パラジュウム:85%)
2. コンタクト保持力 : 500g 以上
3. 基板位置決め用ボス切断跡。

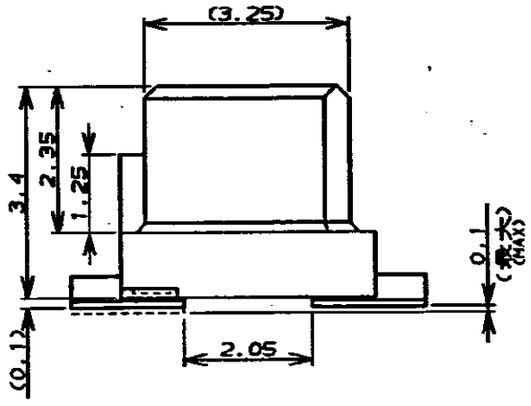
NOTES

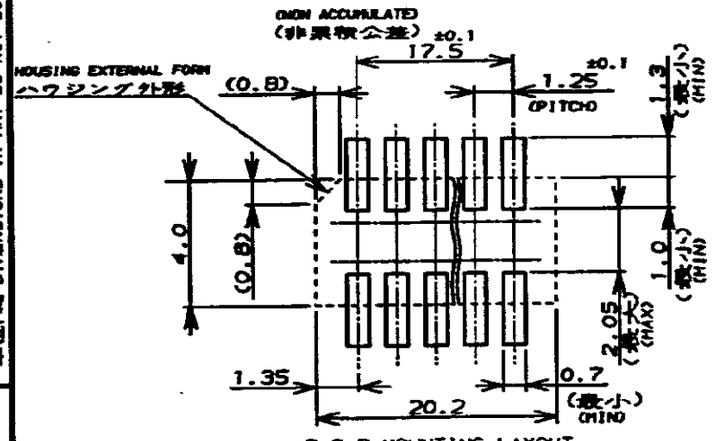
1. MATERIAL & FINISH
   - HOUSING:LCP UL94V-0 (WHITE)
   - CONTACT:Phos-Broz
   - FINISH:DURAGOLD 0.5μ MIN OVER NICKEL 1μ MIN
     (Au:15%,Pd:85%)
2. CONTACT RETENTION FORCE:500g MIN
3. CUT MARK OF POSITIONER BOSS.



SECT "A"-"A"







P.C.B MOUNTING LAYOUT
基板加工寸法
(適用基板厚:0.6mm最小)
(APPLICABLE P.C.B THK : 0.6mm MIN)

30	3-178652-0
極数 Pos.	型番 P/N

Copyright ©19 年
日本エー・エム・ピー株式会社
Copyright ©19__
AMP (Japan), LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.

AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
B	注記1追記 J-13094	[illegible]	[illegible]	2/20/91
A	ハウジング材料変更 J-13094	S.K	J.T / S.K	2/5 '91
0	作成 J-13094	S.K	J.T	12/11 '90

総合電線断面積 (WIRE RANGE) mm² (AWG -)	被覆外径 (INSULATION DIA.) - mm
材料 (MATERIAL) AS SHWON 図中参照	仕上 (FINISH) AS SHWON 図中参照
DR. S.KANEKI 12/11 '90	DE. S.KIKUCHI 12/11 '90
CHK. J.TANIGAWA 12/11 '90	APP. S.KIKUCHI 12/11 '90

名称 (NAME) 1.25 F-P コネクタ (基板対基板接続用) 金めっき仕様 2列仕様 リセヘッダーアッセンブリ 基板垂直取付型 (V) サーフェイスマウント タイプ 基板位置決め用ボス開-リブ低背型
1.25 F-P CONNECTOR CO-TO-CO Au PLATED DOUBLE ROW REC ASM ASM'Y CO SMT TYPE WITHOUT BOSS -IMPROVED TYPE

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)
10以下 : ±0.2
10を超え 30以下 : ±0.25
30を超え 100以下 : ±0.3
角度 : ±3°

SIZE	LOC	番号 (No.)
A3	J	C-178652
尺度 (SCALE) 10-1	REV. B	SHEET 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面

NUMBER C-178652

三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

単位:mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J REV.10/'89